

## 南臺科技大學 106 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	14D02202
課程中文名稱	微機電系統
課程英文名稱	Micro-Electro-Mechanical-Systems
學分數	3.0
必選修	必修
開課班級	四技奈米三乙
任課教師	莊承鑫
上課教室(時間)	週二第 5 節(K401) 週二第 6 節(K401) 週二第 7 節(K401)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	無
輔導考照 2	無
課程概述	讓學生對於微機電系統有總體的概念，其市場應用與理論基礎的範圍，之後再針對微加工製程進行介紹，包括光學微影製程、微機電材料科學、體型微細加工、面型微細加工、封裝測試等。
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標</p> <hr/> <p>1.能了解微機電系統應用與市場 , To be able to understand the applications of MEMS technology and its marketing , 1 工程知識      2.能了解光學微影技術與光罩設計 , To be able to understand the photolithography and photomask design , 2 設計實驗      3.能了解體型微細加工技術 , To be able to understand the Bulk Micromachining technology , 3 實務技術      4.能了解面型微細加工技術 , To be able to understand the Surface Micromachining technology , 3 實務技術      5.能瞭解微機電技術所應用的材料 , To be able to understand the materials for MEMS technology , 10 口語表達溝通</p>
中文課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微機電系統之簡介</li> <li>2. 微機電系統之應用與市場</li> <li>3. 微影技術</li> <li>4. 薄膜沉積</li> </ol>

	5. 蝏刻技術 6. 封裝接合技術 7. 其他微製造技術
英/日文課程大綱	1. Introduction to MEMS 2. Introduction to MEMS Applications and Marketing 3. Lithography 4. Thin film deposition 5. Wet etching 6. Dry etching 7. LIGA Process
課程進度表	
教學方式與評量方法	※課程學習目標，教學方式，評量方式 -----       能了解微機電系統應用與市場，--，-- 能了解光學微影技術與光罩設計，--，-- 能了解體型微細加工技術，--，-- 能了解面型微細加工技術，--，-- 能瞭解微機電技術所應用的材料，--，--
指定用書	
參考書籍	
教學軟體	
課程規範	